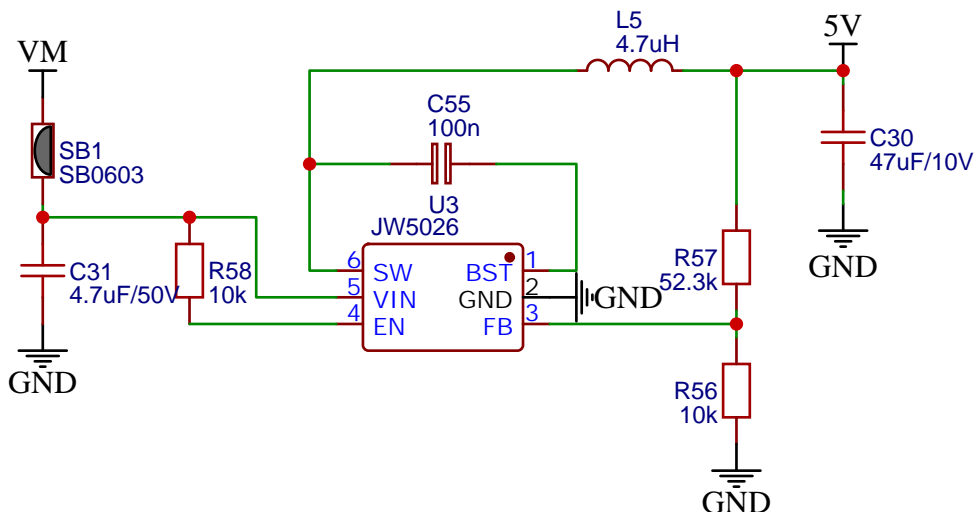
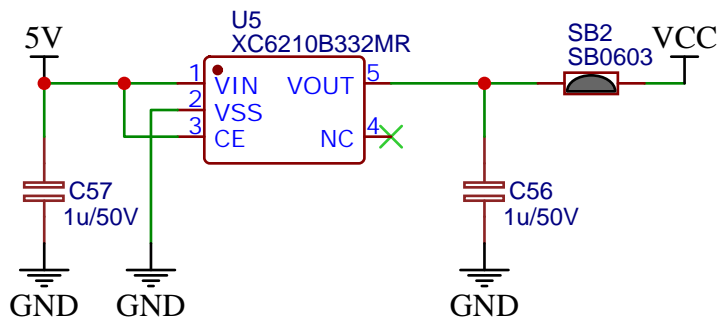


不焊接SB1，焊接SB2，可使用外部LDO，以防止使用内部LDO芯片发热严重
焊接SB1，焊接SB2，全部使用芯片外部电源，避免内部电源供给不足不能工作



VM->5V



5V->VCC

TITLE:

Sheet_1

REV: 1.0



Company: Your Company

Sheet: 1/1

Date: 2022-01-21 Drawn By: 矛盾聚合体